

## パワーモジュールにおける高耐熱パッケージ技術

両角 朗\*, 西村 芳孝\*, 池田 良成\*, 望月 英司\*, 高橋 良和\*

### Packaging Technology for High Temperature Operation of Power Semiconductor Modules

Akira MOROZUMI\*, Yoshitaka NISHIMURA\*, Yoshinari IKEDA\*, Eiji MOCHIZUKI\*, and Yoshikazu TAKAHASHI\*

\* 富士電機株式会社技術開発本部電子デバイス研究所次世代モジュール開発センターパッケージ開発部 (〒390-0821 長野県松本市筑摩 4-18-1)

\* Package Development Div., Next Gen. Module Development Center, Electronic device Laboratory, Corporate R&D Headquarters, Fuji Electric Co., Ltd. (4-18-1, Tsukama, Matsumoto, Nagano 390-0821)